

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2023-007

武汉精测电子集团股份有限公司

关于子公司向银行申请新增综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。根据武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，拟向银行申请最高额不超过4.1亿元人民币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体情况预计如下：

公司名称	银行名称	申请最高授信额度
上海精测	工商银行	2 亿元人民币
	上海银行	1 亿元人民币
	广发银行	8,000 万元人民币
	南京银行	3,000 万元人民币

上述授信额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第十七会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2023年1月11日